



RE711001-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y revestido de laca inhibidora de soldadura
- Impresión de posición por el lado de los componentes
- Placa de circuito impreso con 57 componentes SMD para la introducción en el montaje de superficie SMD:

tipo	número
PLCC	20, 68
QFP	84 sq.
TSOP32	1 x
SO14	1 x
SOM16	1 x
SOL20	1 x
SOT23	3 x
SOT143	1 x
SOT89	2 x
SOT233	1 x
DPAK	1 x
Poti.	1 x
Tantal Chip Kond. A	1 x
Tantal Chip Kond. B	1 x
Tantal Chip Kond. C	1 x
Tantal Chip Kond. D	1 x
1206 Chip Kond.	10 x
0805 Chip Kond.	10 x
1210 Chip Kond.	6 x
1812 Chip Kond.	2 x
2220 Chip Kond.	1 x
2308 Melf	2 x
1206 Mini Melf	6 x

- Adecuada también para la dotación automática (Pick & Place)
- Tamaño: 100 x 140 mm